香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
北京君正集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3223)

修訂公司章程

本公告乃北京君正集成電路股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(1)條作出。

於2026年8月25日，本公司31,287,300股H股(「**H股**」)在香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)發行並上市。因此，本公司已發行股份總數增加至514,951,667股，本公司註冊資本增加至人民幣514,951,667元。

為反映本公司註冊資本及資本結構的上述變動，根據本公司股東於2025年9月11日舉行的股東會上授予本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)的權限，董事會已批准對本公司公司章程(「**公司章程**」)作出相應修訂及內務調整，詳情如下：

修改前：	**修改後：**
第三條 公司於2026年6月22日經中國證監會備案，並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股[●]股，於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。	**第三條** 公司於2026年6月22日經中國證監會備案，並於**2026**年**8**月**24**日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次公開發行境外上市外資股**31,287,300**股，於**2026**年**8**月**25**日在香港聯交所主板上市。

修改前：	修改後：
第六條 公司註冊資本為人民幣[●]元。	**第六條** 公司註冊資本為人民幣**514,951,667**元。
第二十一條 公司已發行的股份數為[●]股，公司的股本結構為：普通股[●]股，其中A股普通股483,664,367股，H股普通股[●]股，不存在其他類別股。	**第二十一條** 公司已發行的股份數為**514,951,667**股，公司的股本結構為：普通股**514,951,667**股，其中A股普通股483,664,367股，H股普通股**31,287,300**股，不存在其他類別股。
第二百〇九條 本章程由公司董事會負責解釋，自股東會審議通過後、自公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司上市之日起生效並實施。	**第二百〇九條 本章程由公司董事會負責解釋，自股東會審議通過後~~、自公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司上市之日起~~生效並實施。**

除上述修訂及調整外，公司章程的所有其他條款保持完全有效。上述修訂及調整無須提交本公司股東會進一步審議或批准。

本公司將就上述公司章程修訂及調整向有關政府或監管機構辦結工商登記、備案及其他相關手續。修訂後的公司章程全文已刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ingenic.com.cn)。

承董事會命
北京君正集成電路股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
劉強博士

中國北京，2026年10月27日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事劉強博士、張緊先生、冼永輝先生及黃磊先生；(ii)非執行董事李杰先生、鄭浩先生及張燕祥女士；及(iii)獨立非執行董事葉金福先生、肖利民博士、于瑩女士及向左先生。